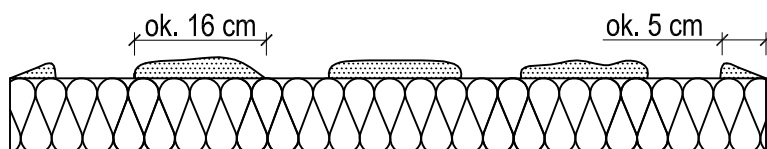


przekrój A - A



$$\frac{P_e}{P} \times 100 \% / 40 \%$$

$P_e$  - efektywna powierzchnia przyklejenia płyty termoizolacyjnej do podłoża

$P$  - powierzchnia płyty termoizolacyjnej przylegająca do ściany

#### UWAGI:

Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoży nienasiąkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych. Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej. Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody obwodowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całościowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).

Projektant jest całkowicie odpowiedzialny za projekt, opis techniczny oraz dokumentację techniczną systemu, w którym użyto materiałów Baumit. Powyższe detale konstrukcyjne powinny służyć tylko jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich użycie w poszczególnych projektach. Baumit zastrzega sobie, że powyższe detale mogą ulegać zmianom. Prosimy o kontakt z firmą Baumit w celu upewnienia się, czy posiadają Państwo najnowszą wersję.